

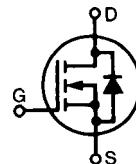
# HiPerFET™ Power MOSFETs

N-Channel Enhancement Mode  
High dv/dt, Low  $t_{rr}$ , HDMOS™ Family

**IXFH 76 N06-11**  
**IXFH 76 N06-12**  
**IXFH 76 N07-11**  
**IXFH 76 N07-12**

$V_{DSS}$	$I_{D25}$	$R_{DS(on)}$
60 V	76 A	11 mΩ
60 V	76 A	12 mΩ
70 V	76 A	11 mΩ
70 V	76 A	12 mΩ

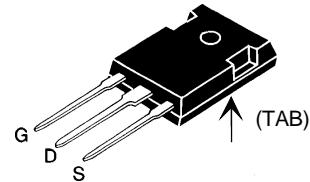
Preliminary data sheet



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
$V_{DSS}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ to $175^\circ\text{C}$	N06	60	V
		N07	70	V
$V_{DGR}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ to $175^\circ\text{C}$ ; $R_{GS} = 10 \text{ k}\Omega$	N06	60	V
		N07	70	V
$V_{GS}$	Continuous		$\pm 20$	V
$V_{GSM}$	Transient		$\pm 30$	V
$I_{D25}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$ (Chip capability = 125 A)		76	A
$I_{D119}$	$T_c = 119^\circ\text{C}$ , limited by external leads		76	A
$I_{DM}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$ , pulse width limited by $T_{JM}$		304	A
$I_{AR}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$		100	A
$E_{AR}$	$T_c = 25^\circ\text{C}$		30	mJ
$E_{AS}$			2	J
$dv/dt$	$I_s \leq I_{DM}$ , $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ , $V_{DD} \leq V_{DSS}$ , $T_j \leq 150^\circ\text{C}$ , $R_G = 2 \Omega$		5	V/ns
$P_D$	$T_c = 25^\circ\text{C}$		360	W
$T_j$			-55 ... +175	$^\circ\text{C}$
$T_{JM}$			175	$^\circ\text{C}$
$T_{stg}$			-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
$M_d$	Mounting torque		1.15/10	Nm/lb.in.
Weight			6	g

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		( $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0 \text{ V}$ , $I_D = 250 \mu\text{A}$	N06	60	V
		N07	70	V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 4 \text{ mA}$		2.0	V
$I_{GSS}$	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$ , $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
$I_{DSS}$	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 \text{ V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$		$100 \mu\text{A}$ $500 \mu\text{A}$
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$ , $I_D = 40 \text{ A}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2 \%$	76N06/N07-11 76N06/N07-12		$11 \text{ m}\Omega$ $12 \text{ m}\Omega$

TO-247 AD



G = Gate, D = Drain,  
S = Source, TAB = Drain

## Features

- International standard package JEDEC TO-247 AD
- Low  $R_{DS(on)}$  HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
  - easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

## Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

## Advantages

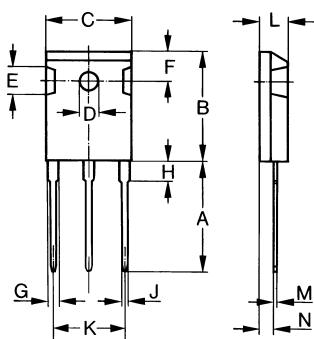
- Easy to mount with 1 screw (isolated mounting screw hole)
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
$g_{fs}$	$V_{DS} = 10 \text{ V}; I_D = 40 \text{ A}$ , pulse test	30	40	S
$C_{iss}$ $C_{oss}$ $C_{rss}$	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 25 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	4400	pF	
		2000	pF	
		1200	pF	
$t_{d(on)}$ $t_r$ $t_{d(off)}$ $t_f$	$V_{GS} = 10 \text{ V}, V_{DS} = 50 \text{ V}, I_D = 30 \text{ A}$ $R_G = 1 \Omega$ (External)	40	ns	
		70	ns	
		130	ns	
		55	ns	
$Q_{g(on)}$ $Q_{gs}$ $Q_{gd}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 40 \text{ A}$	240	nC	
		30	nC	
		120	nC	
$R_{thJC}$			0.42	K/W
$R_{thCK}$			0.25	K/W

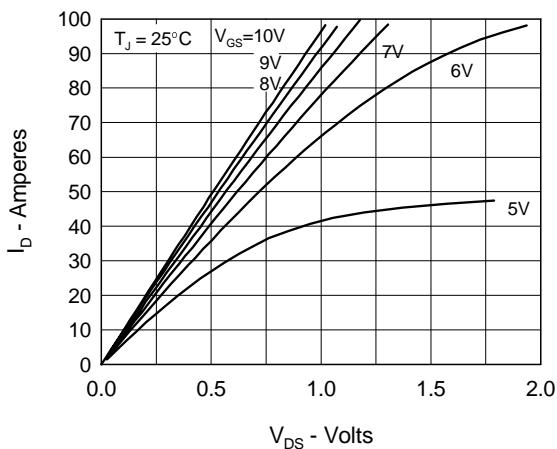
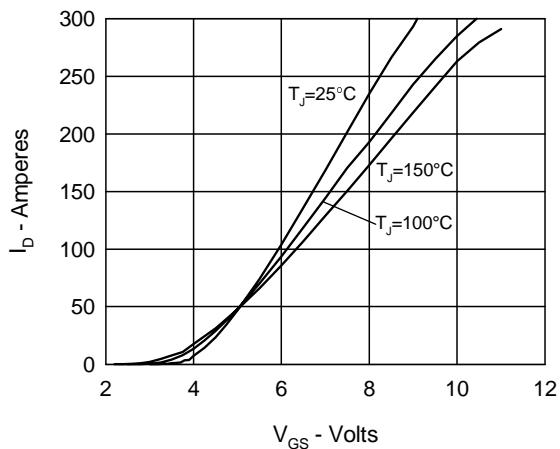
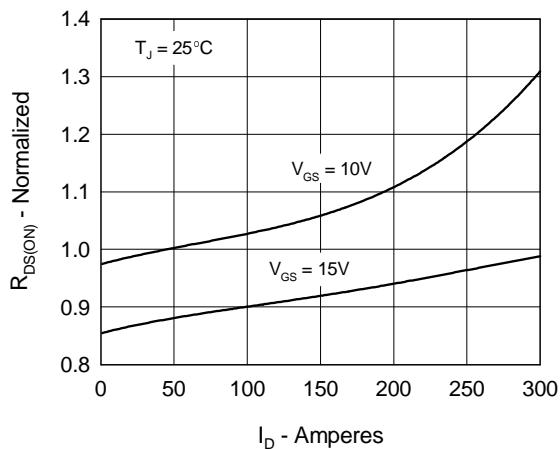
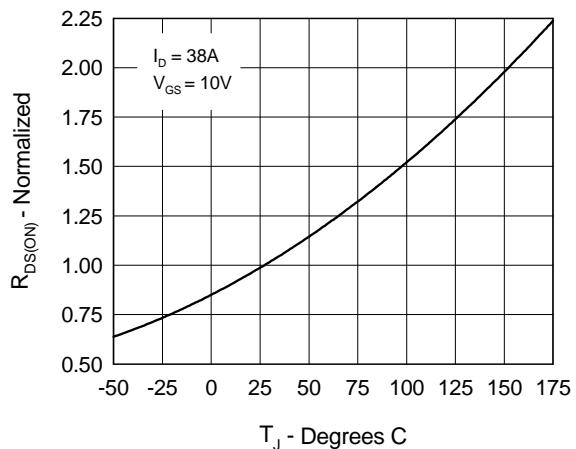
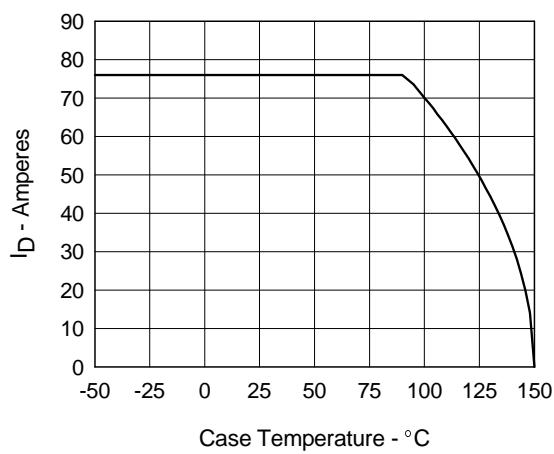
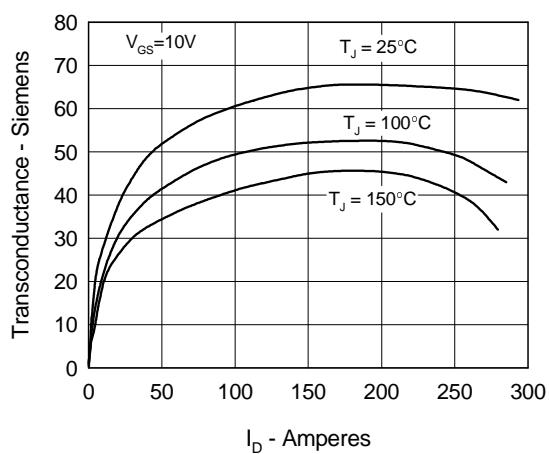
**Source-Drain Diode**
**Characteristic Values**

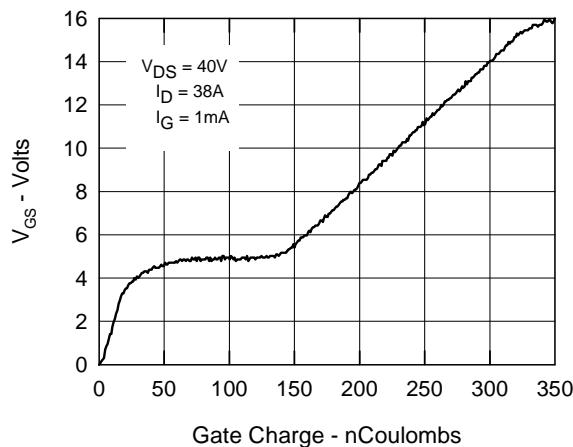
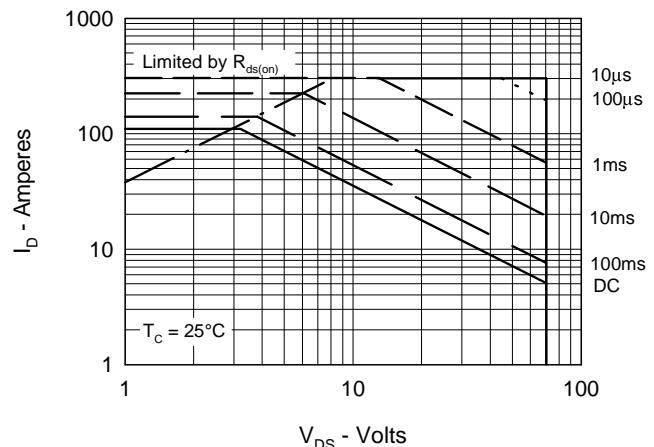
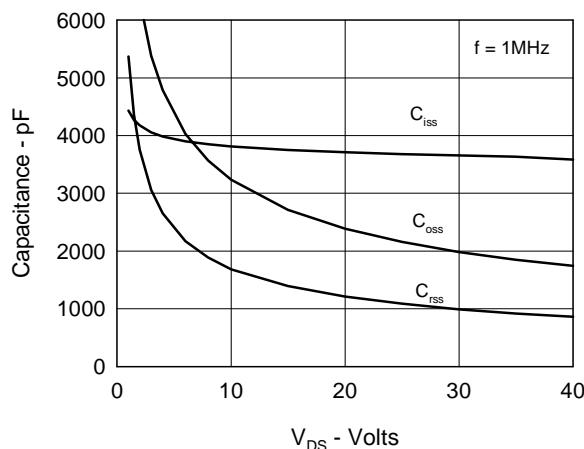
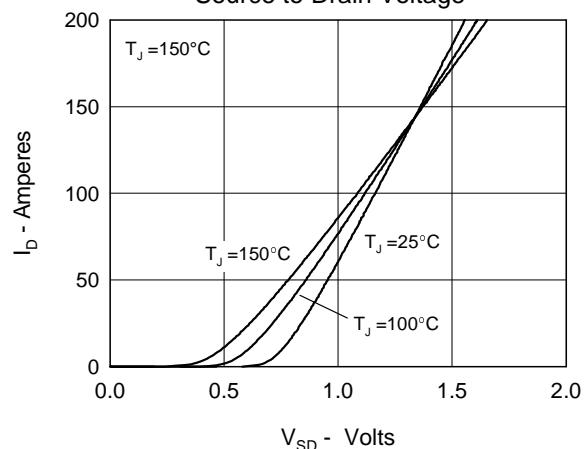
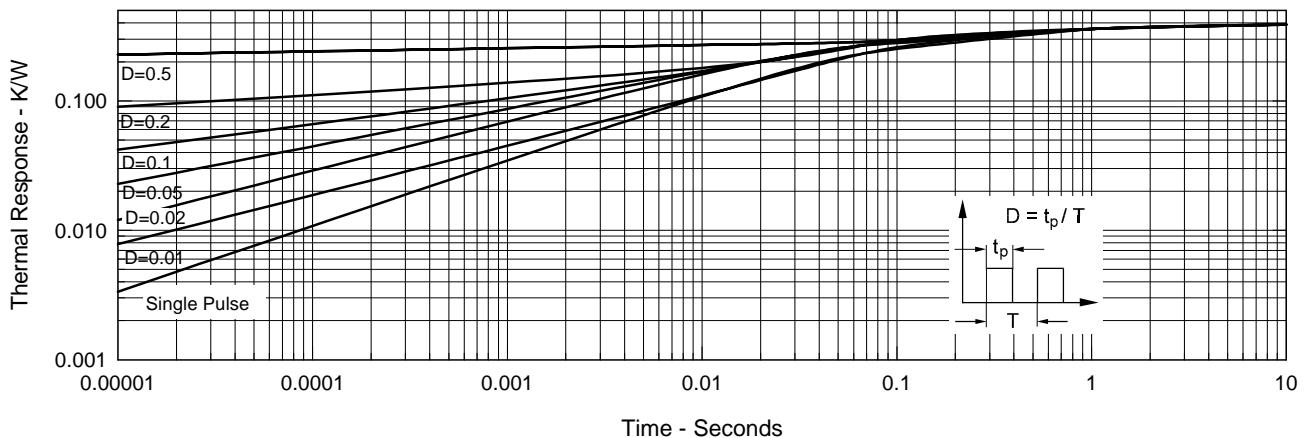
( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
$I_s$	$V_{GS} = 0 \text{ V}$		76	A
$I_{SM}$	Repetitive; pulse width limited by $T_{JM}$		304	A
$V_{SD}$	$I_F = I_s, V_{GS} = 0 \text{ V}$ , Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$ , duty cycle $d \leq 2 \%$		1.5	V
$t_{rr}$	$I_F = 25 \text{ A}, -di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ , $T_J = 25^\circ\text{C}$ $V_R = 25 \text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$	150	ns	
			250	ns

**TO-247 AD (IXFH) Outline**


Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

**Fig.1 Output Characteristics**

**Fig. 2 Input Admittance**

**Fig. 3  $R_{DS(ON)}$  vs. Drain Current**

**Fig. 4  $R_{DS(ON)}$  Temperature Dependence**

**Fig. 5  $I_D$  vs. Case Temperature**

**Fig. 6 Transconductance**


**Fig. 7 Gate Charge**

**Fig. 8 Forward Bias Safe Operating Area**

**Fig. 9 Capacitance Curves**

**Fig. 10 Source Current vs. Source to Drain Voltage**

**Fig. 11 Transient Thermal Impedance**




Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.